

2018-2024年中国硅晶圆行业市场调查及投资战略 研究报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2018-2024年中国硅晶圆行业市场调查及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201712/593892.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

硅晶圆：晶圆便是硅元素加以纯化（99.999%），接着是将这些纯硅制成长硅晶棒，成为制造积体电路的石英半导体的材料，经过照相制版，研磨，抛光，切片等程序，将多晶硅溶解拉出单晶硅晶棒，然后切割成一片一片薄薄的晶圆。

硅晶圆供货吃紧，晶圆设备国产化需求强烈：根据指出，2016年硅晶圆出货总面积为10,738百万平方英寸（millionsquareinches，MSI），高于2015年市场最高点的10,434百万平方英寸，创下历史新高。在总金额方面，2016年的营收金额总计为72.1亿美元，也较2015年营收71.5亿美元成长1%。

全球硅晶圆出货趋势，连续4年增长

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2018-2024年中国硅晶圆行业市场调查及投资战略研究报告》共十六章。首先介绍了硅晶圆相关概念及发展环境，接着分析了中国硅晶圆规模及消费需求，然后对中国硅晶圆市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国硅晶圆面临的机遇及发展前景。您若想对中国硅晶圆有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章硅晶圆行业发展概述

第一节硅晶圆的概述

一、硅晶圆的定义

二、硅晶圆的分类

三、硅晶圆的特点

四、化合物硅晶圆介绍

第二节硅晶圆特性和制备

一、硅晶圆特性和参数

二、硅晶圆制备

第三节产业链结构及发展阶段分析

一、硅晶圆行业的产业链结构

二、硅晶圆行业发展阶段分析

三、行业所处周期分析

第二章全球硅晶圆行业发展分析

第一节世界总体市场概况

- 一、全球硅晶圆的进展分析
- 二、全球硅晶圆市场发展现状
- 三、第二代硅晶圆砷化镓发展概况
- 四、第三代硅晶圆GaN发展概况

第二节世界硅晶圆行业发展分析

- 一、2016年世界硅晶圆行业发展分析
- 二、2017年世界硅晶圆行业发展分析
- 三、2017年硅晶圆行业国外市场竞争分析

第三节主要国家或地区硅晶圆行业发展分析

- 一、美国硅晶圆行业分析
- 二、日本硅晶圆行业分析
- 三、德国硅晶圆行业分析
- 四、法国硅晶圆行业分析
- 五、韩国硅晶圆行业分析
- 六、台湾硅晶圆行业分析

第三章我国硅晶圆行业发展分析

第一节2017年中国硅晶圆行业发展状况

- 一、2017年硅晶圆行业发展状况分析
- 二、2017年中国硅晶圆行业发展动态
- 三、2017年硅晶圆行业经营业绩分析
- 四、2017年我国硅晶圆行业发展热点

第二节2017年硅晶圆行业发展机遇和挑战分析

- 一、2017年硅晶圆行业发展机遇分析
- 二、2017年金融危机对硅晶圆行业影响

第三节2017年中国硅晶圆市场供需状况

- 一、2017年中国硅晶圆行业供给能力
- 二、2017年中国硅晶圆市场供给分析
- 三、2017年中国硅晶圆市场需求分析
- 四、2017年中国硅晶圆产品价格分析

第四章硅晶圆产业经济运行分析

第一节营运能力分析

- 一、2015年营运能力分析
- 二、2017年营运能力分析

第二节偿债能力分析

一、2016年偿债能力分析

二、2017年偿债能力分析

第三节盈利能力分析

一、资产利润率

二、销售利润率

第四节发展能力分析

一、资产年均增长率

二、利润增长率

第五章半导体产业分析

第一节全球半导体行业发展分析

一、2016年全球半导体厂商竞争情况

二、2017年全球半导体厂商竞争情况

三、2017年全球半导体行业发展分析

四、2017年金融危机对行业影响分析

五、2017年全球半导体行业发展形势

第二节中国半导体产业发展分析

就半导体各类设备销售额而言，2017年以晶圆处理设备(waferprocessingequipment)销售额为最高，达398亿美元，占当年所有半导体设备总销售额的80.6%（其中光刻设备约占20%，刻蚀设备约占15%，沉积设备约占15%）。其次为半导体测试设备的39亿美元，占7.9%。封装设备销售额为34亿美元，占6.9%。至于包括厂务设备(fabfacilitiesequipment)、晶圆制造设备(wafermanufacturingequipment)、光罩设备(mask/reticleequipment)等在内的其他前端(front-end)设备销售额为23亿美元，占4.7%。

半导体设备中各类设备销售额占比：晶圆处理设备约占8成

数据来源：公开资料整理

一、2017年中国半导体采购情况分析

二、2017年中国半导体市场增长分析

三、2017年中国半导体市场规模分析

半导体分类设备销售规模为：光刻设备160亿元/年、刻蚀设备120亿元/年、镀膜设备120亿元/年、其他晶圆处理设备240亿元/年；测试设备64亿元/年、封装设备56亿元/年、其他前端设备40亿元/年。

| 2016-2020年，中国半导体设备销售规模拆分 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
|-------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 2017-2020合计 中国半导体设备销售规模((美元)) | 64.6 | 68.4 | 110.4 | 154.6 | 154.6 |
| 同比增长 | +31.8% | +5.9% | +61.4% | +40.0% | 0.0% |
| 晶圆处理设备 | 13.7 | 22.1 | 30.9 | 30.9 | 97.6 |
| 光刻设备 (占比20%) | 13.7 | 22.1 | 30.9 | 30.9 | 97.6 |
| 刻蚀设备 (占比15%) | 9.7 | 10.3 | 16.6 | 23.2 | 23.2 |
| 镀膜设备 (占比15%) | 9.7 | 10.3 | 16.6 | 23.2 | 23.2 |
| 其他 (占比30%) | 19.4 | 20.5 | 33.1 | 46.4 | 46.4 |

46.4 146.4 测试设备（占比8% 5.2 5.5 8.8 12.4 12.4 39.0 封装设备（占比7%） 4.5 4.8 7.7
10.8 10.8 34.2 其他前端设备（占比5%） 3.2 3.4 5.5 7.7 7.7 24.4

数据来源：公开资料整理

四、2017年中国半导体行业投资分析

五、2017年中国半导体行业发展形势

第三节半导体照明行业发展分析

一、2017年中国半导体照明产业数据

二、2017年中国半导体照明产业分析

三、半导体照明市场应用前景分析

四、七大半导体照明产业发展规划

第四节硅晶圆行业发展分析

一、2017年全球硅晶圆的出货量

二、2017年全球硅晶圆销售预测

三、2017年中国硅晶圆发展分析

四、2017年硅晶圆市场增长预测

第五节半导体行业发展预测

一、2017年全球硅晶圆市场预测

二、2017年中国硅晶圆发展前景

三、2014-2017年半导体行业的复合增长率

四、硅晶圆市场增长预测

第六章主要硅晶圆发展分析

第一节12英寸晶圆

报告显示，由于450mm（18英寸）晶圆的前景褪色，2016年至2021年期间，预计将有25家300mm（12英寸）晶圆厂重出江湖，而晶圆厂越来越多地投入使用300mm（12英寸）和200mm（8英寸）直径的硅基板制造工厂的产品。

直至2020年左右，12英寸晶圆仍为主流

数据来源：公开资料整理

一、国内外多晶硅产业概况

二、单晶硅和外延片发展概况

三、中国硅晶体材料产业特点

四、我国多晶硅产业发展现状分析

五、2014-2017年多晶硅行业发展趋势

第二节18英寸晶圆

一、18英寸晶圆产业发展概况

二、18英寸晶圆发展概况

三、我国18英寸晶圆产业链发展情况分析

四、砷化镓产业需求分析

第三节8英寸晶圆

一、8英寸晶圆的特性与应用

二、8英寸晶圆的应用前景

三、8英寸晶圆市场发展现状

四、8英寸晶圆产业市场投资前景

第四节10nm

半导体设备摩尔定律揭示半导体行业发展，目前已进入10nm制程量产时代：摩尔定律是由英特尔（Intel）创始人之一戈登·摩尔（Gordon Moore）提出来的。其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。换言之，每一美元所能买到的电脑性能，将每隔18-24个月翻一倍以上。目前已进入10nm制程量产，向7nm制程寻求突破的时代。

摩尔定律揭示半导体行业发展，目前已进入10nm制程量产时代

数据来源：公开资料整理

一、10nm概况

二、10nm生产企业分析

三、国内10nm发展情况

四、2014-2017年10nm市场发展趋势

第七章硅晶圆产业发展地区比较

第一节长三角地区

一、竞争优势

二、发展状况

三、2018-2024年发展前景

第二节珠三角地区

一、竞争优势

二、发展状况

三、2018-2024年发展前景

第三节环渤海地区

一、竞争优势

二、发展状况

三、2018-2024年发展前景

第四节东北地区

一、竞争优势

二、发展状况

三、2018-2024年发展前景

第五节西部地区

一、竞争优势

二、发展状况

三、2018-2024年发展前景

第八章硅晶圆行业竞争格局分析

第一节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节硅晶圆制造业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业出口交货值对比分析

五、重点企业利润总额对比分析

六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节硅晶圆行业竞争格局分析

一、2017年硅晶圆制造业竞争分析

二、2017年中外硅晶圆产品竞争分析

三、国内外硅晶圆竞争分析

四、我国硅晶圆市场竞争分析

五、我国硅晶圆市场集中度分析

六、2018-2024年国内主要硅晶圆企业动向

第九章硅晶圆企业竞争策略分析

第一节硅晶圆市场竞争策略分析

一、2017年硅晶圆市场增长潜力分析

二、2017年硅晶圆主要潜力品种分析

三、现有硅晶圆产品竞争策略分析

四、潜力硅晶圆品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节硅晶圆企业竞争策略分析

一、金融危机对硅晶圆行业竞争格局的影响

二、金融危机后硅晶圆行业竞争格局的变化

三、2018-2024年我国硅晶圆市场竞争趋势

四、2018-2024年硅晶圆行业竞争格局展望

五、2018-2024年硅晶圆行业竞争策略分析

六、2018-2024年硅晶圆企业竞争策略分析

第十章主要硅晶圆企业竞争分析

第一节中芯国际

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第二节英特尔

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第三节淮安德科玛

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第四节华力微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第五节北方华创

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第六节中微半导体

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第七节盛美半导体

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第八节晶盛机电

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

四、2018-2024年发展战略

第十一章硅晶圆行业发展趋势分析

第一节2017年发展环境展望

一、2017年宏观经济形势展望

二、2017年政策走势及其影响

三、2017年国际行业走势展望

第二节2017年硅晶圆行业发展趋势分析

一、2017年技术发展趋势分析

二、2017年产品发展趋势分析

三、2017年行业竞争格局展望

第三节主要硅晶圆的发展趋势

一、硅材料

二、GaAs和InP单晶材料

三、半导体超晶格、量子阱材料

四、一维量子线、零维量子点半导体微结构材料

五、宽带隙硅晶圆

六、光子晶体

七、量子比特构建与材料

第四节2018-2024年中国硅晶圆市场趋势分析

一、硅晶圆市场趋势总结

二、2018-2024年硅晶圆发展趋势分析

三、2018-2024年硅晶圆市场发展空间

四、2018-2024年硅晶圆产业政策趋向

五、2018-2024年硅晶圆技术革新趋势

六、2018-2024年硅晶圆价格走势分析

第十二章未来硅晶圆行业发展预测

第一节2018-2024年国际硅晶圆市场预测

一、2018-2024年全球硅晶圆行业产值预测

二、2018-2024年全球硅晶圆市场需求前景

三、2018-2024年全球硅晶圆市场价格预测

第二节2018-2024年国内硅晶圆市场预测

一、2018-2024年国内硅晶圆行业产值预测

二、2018-2024年国内硅晶圆市场需求前景

三、2018-2024年国内硅晶圆市场价格预测

第三节2018-2024年市场消费能力预测

一、2018-2024年行业总需求规模预测

二、2018-2024年主要产品市场规模预测

三、2018-2024年市场供应能力预测

第十三章硅晶圆行业发展环境分析

第一节国内硅晶圆经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2017年中国硅晶圆经济发展预测分析

第二节中国硅晶圆行业政策环境分析

第十四章硅晶圆行业投资机会与风险

第一节行业活力系数比较及分析

一、2017年相关产业活力系数比较

二、2017年行业活力系数分析

第二节行业投资收益率比较及分析

一、2017年相关产业投资收益率比较

二、2017年行业投资收益率分析

第三节硅晶圆行业投资效益分析

一、硅晶圆行业投资状况分析

二、2018-2024年硅晶圆行业投资效益分析

三、2018-2024年硅晶圆行业投资趋势预测

四、2018-2024年硅晶圆行业的投资方向

五、2018-2024年硅晶圆行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节影响硅晶圆行业发展的主要因素

一、2018-2024年影响硅晶圆行业运行的有利因素分析

二、2018-2024年影响硅晶圆行业运行的稳定因素分析

三、2018-2024年影响硅晶圆行业运行的不利因素分析

四、2018-2024年我国硅晶圆行业发展面临的挑战分析

五、2018-2024年我国硅晶圆行业发展面临的机遇分析

第五节硅晶圆行业投资风险及控制策略分析

一、2018-2024年硅晶圆行业市场风险及控制策略

二、2018-2024年硅晶圆行业政策风险及控制策略

三、2018-2024年硅晶圆行业经营风险及控制策略

四、2018-2024年硅晶圆行业技术风险及控制策略

五、2018-2024年硅晶圆同业竞争风险及控制策略

六、2018-2024年硅晶圆行业其他风险及控制策略

第十五章(ZYZF)硅晶圆行业投资战略研究ZYZF

第一节硅晶圆行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节对我国硅晶圆品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、硅晶圆实施品牌战略的意义

三、硅晶圆企业品牌的现状分析

四、我国硅晶圆企业的品牌战略

五、硅晶圆品牌战略管理的策略

第三节硅晶圆行业投资战略研究

一、2017年电子信息产业投资战略

二、2017年硅晶圆行业投资战略

三、2018-2024年硅晶圆行业投资战略

四、2018-2024年细分行业投资战略ZYZF

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201712/593892.html>